

Схема процесса подготовки медной поверхности печатных плат MесEtchBond

Предварительная очистка MEKLEEN MAC-5330 Обезжиривание (опция)	Температура 20 - 30 ° С (стандарт 35 ° С) Время погружения: 10-30 сек Давление распыления: 0,1 – 0,3 МПа Время обработки: 15 сек
промывка водой (3 ступени)	
Микротравление CZ-8100	Температура 30 - 40 ° С (стандарт 35 ° С) Давление распыления: 1 - 2 кг / см ² Скорость травления: пригл. 0,7 (до 4 мкм) Время обработки: 25-90 сек.
Промывка водой	
Кислотная промывка 10,0% объем, 35% р-р HCl Удаление шлама	Температура 20 - 30 ° С Давление распыления: 0,3-0,6 кг / см ² Время: 10-15 сек.
Промывка водой (более 2 раз)	
Обработка от окисления CL-8300 Образование органической пленки (опция)	Погружать или распылять 20 - 30 ° С Время: 10 - 15 сек.
Промывка	
Сушка	

Область применения процесса микротравления MесEtchBond практически не ограничены. Сочетание процессов **MесEtchBond 8100** и процессом **CL-8300** широко используется в качестве альтернативы технологии черного оксидирования меди, что дает высочайшие результаты по силе адгезии.

Адгезия меди со смолой увеличивается благодаря механическому сцеплению за счет микрорельефа поверхности меди и химического сцепления за счет образования химических связей между органическим слоем CL-8300 и смолой.